

Presseinformation

**Chemnitz,
14. Mai 2012**



Tino Petsch, Vorstandsvorsitzender der 3D-Micromac AG, moderiert die Diskussion nach dem Vortrag über die Fertigung flexibler organischer Photovoltaik-Module von Dr. Ralph Wichtenthal (re.) von der Heliatek GmbH. Im Rahmen der Einweihung des microFLEX-Centers luden die 3D-Micromac AG und das Fraunhofer ENAS zu einer Vortragsreihe rund um die Themen Smart Systems und Fertigung auf flexiblen Substraten ein.
(Bild: Fraunhofer ENAS)

Einweihung microFLEX-Center durch Fraunhofer ENAS und 3D-Micromac AG

Zeitgleich zum 10-jährigen Firmenjubiläum der 3D-Micromac AG wurde am 11. Mai 2012 das microFLEX-Center auf dem Smart Systems Campus Chemnitz durch die neuen Mieter, die 3D-Micromac AG und das Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme ENAS, eingeweiht. In der neuen Forschungs- und Produktionsstätte werden rund 130 Mitarbeiter gemeinsam arbeiten, etwa 70 davon vom Fraunhofer ENAS.

In ihrem Grußwort gratulierte die Staatministerin Professor Sabine von Schorlemmer nicht nur der 3D-Micromac AG zu ihrer eindrucksvollen Unternehmensentwicklung sondern würdigte insbesondere, dass mit der Eröffnung des microFLEX-Centers auf dem Smart Systems Campus Chemnitz die Kooperation zwischen der 3D-Micromac AG und dem Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme ENAS weiter manifestiert wird. Sowohl die 3D-Micromac AG als auch das Fraunhofer ENAS haben sich in den zurückliegenden drei Jahren so dynamisch entwickelt, dass die erst 2009 bezogenen Gebäude nicht mehr ausreichen. „Sachsen unterstützt Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, denn nur der ständige Innovationprozess sichert das Bestehen im internationalen Wettbewerb“, ergänzt die Wissenschaftsministerin und überreicht einen Zuwendungsbescheid für ein neues Forschungsvorhaben zum Thema „Wellengestützte Funktionalisierung von Schichten für Anwendungen in der flexiblen Elektronik“. Mit diesem Verbundvorhaben entwickeln die 3D-Micromac AG mit ihren Kooperationspartnern – DTF Technology GmbH, Fraunhofer ENAS, Hochschule Mittweida, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, miTec Microtechnologie GmbH und Richter & Heß Verpackungsservice GmbH – neue Technologien zur Herstellung von flexibler Elektronik. Das Vorhaben wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Freistaats Sachsen unterstützt.

Professor Ulrich Buller, Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft, würdigte ebenfalls die äußerst positive Entwicklung beider Partner und ihre intensive Kooperation. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Chemnitz, Barbara Ludwig, blickte mit Stolz auf die weitere Entwicklung des Smart System Campus Chemnitz.

Die 3D-Micromac AG und das Fraunhofer ENAS verbindet seit Jahren eine intensive Kooperation. Begonnen hat alles jedoch am Zentrum für Mikrotechnologien der TU Chemnitz mit dem Laser-Trimmen von Mikrosiegeln.

**Fraunhofer-Institut für
Elektronische Nanosysteme
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Technologie-Campus 3
09126 Chemnitz
Telefon +49 (0) 371 45001-0
Telefax +49 (0) 371 45001-101
E-Mail: info@enas.fraunhofer.de
<http://www.enas.fraunhofer.de>**

Daran schlossen sich gemeinsame Arbeiten zu stressfreien Spiegeln an. Fortgesetzt wurden die F&E-Kooperation durch Untersuchungen und Versuche zum Laserstrukturieren von Polymermaterialien für die Mikrofluidik. Heute nutzt das Fraunhofer ENAS mehrere Anlagen der 3D-Micromac AG zur Laserbearbeitung von verschiedensten Materialien.

Der Name microFLEX-Center steht für ein Geschäftsfeld. Mit dem modularen Fertigungssystem microFLEX™ entwickelten die 3D-Micromac AG, das Fraunhofer ENAS und die TU Chemnitz eine vollständige Fertigungslinie zur Produktion von flexiblen Systemen. Neben Laserprozessen können auch Druck- und Beschichtungstechnologien wie zum Beispiel Gravur-, Ink-Jet-Druck und Slot-Die-Coating in das System integriert werden. Auch die Vor- oder Nachbehandlung aufgebrachter Materialien lässt sich mit angepassten Modulen während des ablaufenden Prozesses realisieren.

Darüber hinaus werden im microFLEX-Center weitere Schwerpunktthemen, wie die Laserbearbeitung von Polymermaterialien insbesondere von Lab-on-a-chip-Systemen für die Point-of-care Diagnostik und die Zuverlässigkeit von Speichermodulen für die Elektromobilität gemeinsam vorangetrieben.